

# 第34回マイクロエレクトロニクスシンポジウム2024



## MES2024 論文・展示募集

開催日・講演発表日：2024年9月11日(水)～13日(金)

開催会場：大同大学（名古屋市） & オンライン開催

交流会：9月12日(木) ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（金山駅）

発表・展示申込期間：5月1日～6月21日(金)まで延長！

論文提出期間：6月25日(火)～7月22日(月)

＜MES2024ホームページ＞ \* 詳細および最新の情報はこちらからご参照ください

<https://jiep.or.jp/event/mes/mes2024/index.php>



### 1. 一般発表

#### 口頭発表 または ポスター発表

- 1) 先端プロセス・実装技術（配線板、インターポーザ、積層技術、チップレット、ハイブリッドボンディングなど）
- 2) パワーエレクトロニクス実装技術（パワーデバイス実装、サーマルマネジメント、高熱伝導材料、耐熱材料など）
- 3) 高速高周波実装・電磁特性技術（電源回路、高速伝送線路、アンテナ、ワイヤレス給電、人体通信、EMC、ミリ波など）
- 4) マイクロメカトロニクス実装技術（MEMS、封止パッケージ、常温接合、センサ・アクチュエータなど）
- 5) 光回路実装技術（光インタコネクション、CPO、光モジュール、シリコンフォトニクスなど）
- 6) プリントブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス（アディティブマニファクチャリング、バイオセンサ、生体適合性材料など）
- 7) 環境調和型エレクトロニクス（グリーンエネルギー、蓄電池、光電変換、環境調和型実装材料など）
- 8) 信頼性技術（熱応力、機械疲労、マイグレーション、寿命予測など）
- 9) シミュレーション・計算機による評価・設計（AI活用、機械学習、熱応力解析、疲労解析、回路シミュレーションなど）
- 10) めっき技術（配線形成、スルーホールめっき、高密着技術、表面処理など）
- 11) 最先端材料（配線材料、接合材料、基板材料、ナノマテリアル、メタマテリアルなど）
- 12) その他

### 2. 企業展示

#### 展示スペース、プレゼンテーション、バナー広告、広告掲載

- ① 展示スペース（企業PR可能：机180cm×60cm、椅子、ボード90cm×118cm、電源）
- ② コアタイムセッション（1時間予定）
- ③ 企業プレゼンテーション（1社10分ほどの発表）
- ④ バナー広告（MES2024ホームページ：会社ロゴ掲載・URLリンク）
- ⑤ 論文集への広告掲載（MES2024論文集の広告掲載）
- ⑥ 交流会参加1名無料（企業展示申込1社につき1名参加無料）
- ⑦ 論文集冊子版1冊無料（開催終了後2～3週間後に発送予定）
- ⑧ 説明補助員追加登録特権（展示やプレゼンの説明補助員の追加特権）

# マイクロエレクトロニクスシンポジウム2024 (MES2024)

## ◆特別講演◆ 9月12日(木)午後予定

### 1. 「企業経営と大学経営 双方に携わって思うこと」 武藤 大 氏 (学校法人大同学園 理事長)

2019年に本学園の理事長に就任しましたが、前職は鉄鋼会社に37年間勤務していました。縁あって学校法人の経営を任せ、企業経営と学校経営とで違いを感じることや、企業と大学の連携に関して思うことが多々あります。

講演では、大同特殊鋼グループの事業と本学会にご参加の皆さまにも身近な製品をいくつかご紹介し学園の歴史や建学の精神をお話いたします。また、企業経営と大学経営との双方に携わって考えていることの中から、研究マネジメントに対する考え方や取り組みスタンスの違いと、ますます早期化している就職(採用)活動と学事日程のずれ違い、それらから大学と企業が一体となって取り組むべきと考えている事についてお話したいと思います。



### 2. 「三菱電機のパワーモジュールの技術動向」 別芝 範之 氏 (三菱電機株式会社 コンポーネント製造技術センターパワーデバイス・モジュール技術推進部 部長)

三菱電機では、重点成長事業の一つとしてパワーデバイス事業の強化に取り組んでいます。当社はパワーデバイス・パワーモジュールおよびこれらを搭載した応用製品を一貫して手掛けており、様々な分野で活用いただいております。今回の発表では、パワーモジュールのアセンブリ技術について、学会や当社の三菱電機技報で報告した内容を元に最新の動向について説明させていただきます。

## 参加費一覧

発表者・聴講者(参加者)		参加登録期間	早期参加費 2024年7月31日迄	通常参加費 2024年8月1日～9月12日迄	
参加(聴講)者 口頭発表者 ポスター発表者	会員	正会員	15,000円	17,000円	
		海外会員	15,000円	17,000円	
		若手会員	15,000円	17,000円	
		シニア会員	7,000円	9,000円	
		学生会員	3,500円	4,000円	
		名誉会員	無料		
		賛助会員	賛助会員	15,000円	17,000円
	クーポン	使用可(無料)			
	共催会員	一般	15,000円	17,000円	
		学生	3,500円	4,000円	
協賛会員	一般	20,000円	22,000円		
	学生	4,500円	5,000円		
非会員	一般	28,000円	30,000円		
	学生	5,500円	6,000円		
オプション	交流会(先着140名)	6,000円			
	論文集冊子版	3,000円			
企業展示 (企業セッション)		参加登録期間	参加登録費 2024年6月14日迄	特権	
企業展示	会員	正会員	50,000円	企業展示スペース プレゼンテーション バナー広告(ロゴ掲載・リンクURL) 論文集 広告掲載 交流会参加費 1名無料 論文集冊子版 1冊無料	
		共催会員			
賛助会員					
	非会員	一般	100,000円		
企業展示登録後	補助員	1名につき	10,000円	交流会参加費 無料	

## 【企業展示】6月21日(金)まで延長 募集中!

ソニーセミコンダクタソリューションズ(株), 奥野製薬工業(株), シーメンス(株), (株)スフィンクス・テクノロジーズ, (株)図研, JCU(株), (株)サーモグラフィティクス, メルテックス(株), (株)野田スクリーン, 住友金属鉱山(株), サンエレクトロニクス(株), オムロン(株), ティー・エイ・インストルメント・ジャパン(株), タカヤ(株)

## 【協賛団体】予定

IEEE EPS Japan Chapter, 映像情報メディア学会, 応用物理学会, 化学工学会, 関西サイエンス・フォーラム, KEC 関西電子工業振興センター, 高分子学会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電子情報技術産業協会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本セラミクス協会, 日本電子回路工業会, 日本電子材料技術協会, 日本ロボット工業会, 光産業技術振興協会, 表面技術協会, 溶接学会, 粉体粉末冶金協会

主催：一般社団法人 エレクトロニクス実装学会  
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2  
お問合せMail：E-mail: mes2024@jiep.or.jp  
ホームページ: <https://jiep.or.jp>



共催  
予定

